

# 46-704 / 46-705 Economy Version

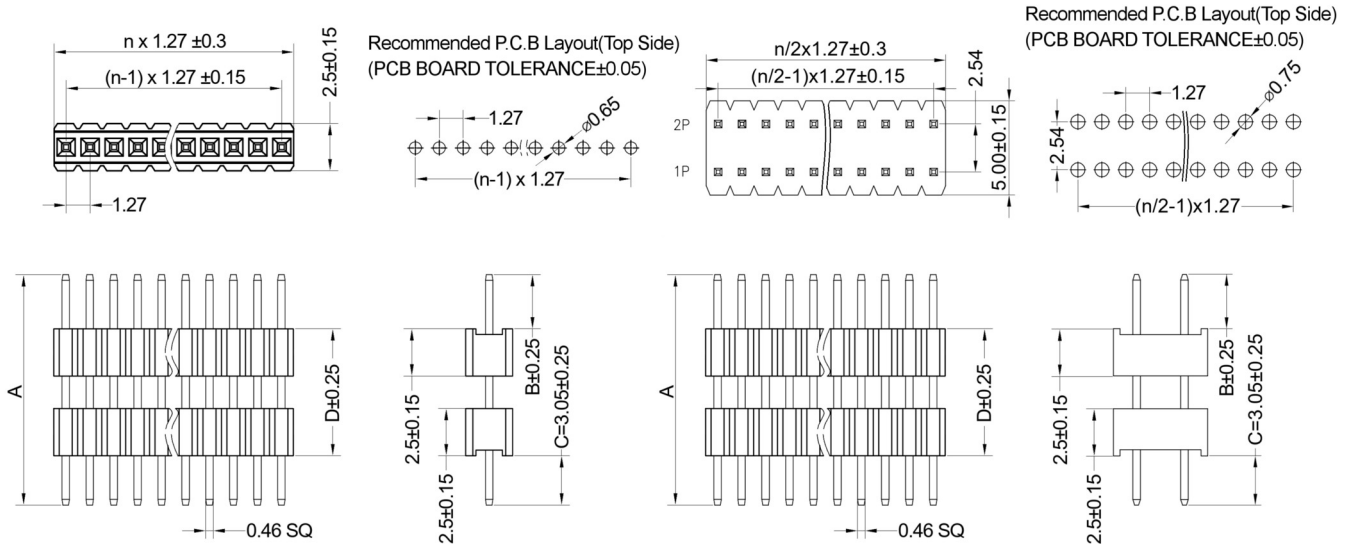
Sandwich-Stiftleisten RM 1,27x2,54mm, 1-/2-reihig  
Dual Body Pin Headers, 1.27x2.54mm Pitch, Single/Double Row

## Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,64mm, Kupferlegierung <i>0.64mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Au über Ni <i>Au over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ <i>&lt; 20 mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ <i>&gt; 1000 MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC/DC <i>500 V AC/DC</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A <i>1 A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C <i>-40 °C ... +105 °C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	230 °C für 30-60 Sekunden (260 °C für 10 Sekunden) <i>230 °C for 30-60 seconds (260 °C for 10 seconds)</i>



Passende Buchsenleisten:  
*Compatible Female Headers:*  
**46-709 46-710**



### Series\*

**46-704**

**46-704** Einreihig  
*Single row*  
**46-705** Zweireihig  
*Double row*

### Contacts\*

**030**

**002-040** Einreihig  
*Single row*  
**004-080** Zweireihig  
*Double row*

### Dimensions\*

**10**

**10** A=11,00 B=2,87 D=5,08mm  
**15** A=12,90 B=3,05 D=6,80mm  
**20** A=15,90 B=3,05 D=9,80mm  
**25** A=17,90 B=3,05 D=11,80mm  
**30** A=21,00 B=3,05 D=14,90mm  
A- Kundenspezifisch (Einreihig max. 45,0mm, Zweireihig max. 21,0mm)  
*Customer-specific (single row max. 45.0mm, double row max. 21.0mm)*

### Plating

**00**

**00** Vergoldet  
*Gold plated*

Max. Polzahl für Stiftmaße zwischen 21,0 - 45,0mm = 20P  
*Max. contact number for dimensions between 21.0 - 45.0mm = 20P*

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

# Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	untere Temperaturangabe [°C]
Verweildauer oberhalb $T_L$	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	obere Temperaturangabe [°C]
Dauer Höchsttemperatur	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	Lower Temperature [°C]
Duration above $T_L$	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	Upper Temperature [°C]
Duration Peak Temperature	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min

